

Cu-ETP, Cu-PHC verzinnt

Das Verzinnen der Kupferfolien verbessert die Lötbarkeit der Oberfläche und die Korrosionseigenschaften. Bei der Verzinnung durch Walzplattieren (zusammenwalzen von Kuper und Zinnfolien) ist eine flussmittelfreie Verzinnung und der Einsatz diverser Zinnlegierungen möglich. Durch das Plattieren wird eine sehr gute Haftung erzeugt. Der Plattierverbund wird durch das nachfolgende Kaltwalzen zu der gewünschten Dicke mit gleichbleibender Zinnaufgabe über die gesamte Länge und Breite der Folie verarbeitet. Durch das Plattieren sind sowohl einseitige als auch beidseitige Verzinnungen möglich.

KERNBAND	ZINNAUFLAGE	SCHMELZTEMPERATUR DER ZINNAUFLAGE	ROHS-KONFORMITÄT
Cu-ETP nur für R200	· Sn96,8Sb1,6Zn1,6Pb0,2 (Sn96,8)	232 °C	
Cu-PHC nur für R360	· Sn100	232 °C	✓
	· Sn96,5Ag3,5	221 °C	✓
	· Sn62Pb36Ag2	179 °C	
	· Sn60Pb40	183 – 190 °C	
	· Sn96,5Ag3Cu0,5	217 – 220 °C	✓
	· Sn97,5Cu2,25Ag0,25	226 – 232 °C	✓

LIEFERFORM	DICKE	BREITE
Rollen, Spulen, Ringe	0,01 - 0,4 mm	0,6 - 320 mm (andere auf Anfrage)
<i>nicht alle Kombinationen aus Dicke und Breite sind möglich</i>		

ZINNAUFLAGE Herstellungsart	AUFLAGENART	AUFLAGENDICKE bezogen auf die Gesamtdicke	OBERFLÄCHE
• plattiert flussmittelfrei, Folienkanten sind unverzinnt	· einseitig · beidseitig	4 %; 5,6 %; 10 % und 13 %	· Oberfläche mit Walzstruktur · Reflowbehandlung
• plattiert und feuerverzint¹ , flussmittelfrei, Folienkanten sind unverzinnt	· beidseitig	4 %	· Reflow

¹ *plattiert und feuerverzint = plattieren mit Sn96,8 und anschließend feuerverzinnen mit Sn60Pb40 ist nur für die Folien mit einer Gesamtdicke 0,05 mm möglich*

TYPISCHE ZUSTANDSWERTE (nur zu Info)

	Zugfestigkeit Rm in MPa	Streckgrenze Rp0,2 in MPa	Dehnung in % Lo = 100 mm
R200	≤ 250	≤ 100	> 10
R360	≥ 360	≥ 320	< 5

Tabellenwerte gelten für Folien > 0,1 mm Dicke

Weitere Infoblätter finden Sie auf unserer Webseite: <https://www.schlenk.com>